

三次元実装に向けたパッケージング技術

高橋 知子*, 勝又 章夫**

Semiconductor Packaging Technology for 3D Assembly

Tomoko TAKAHASHI* and Akio KATSUMATA**

* 株式会社ジェイデバイス開発センター設計部設計第一担当 (〒 221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 1-1-32 ニューステージ横浜 17F)

** 株式会社ジェイデバイス開発センター (〒 221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 1-1-32 ニューステージ横浜 17F)

* Design Group1, Design DEPT., Packaging Research & Development Center, J-DEVICES Corp. Yokohama Head Office (New Stage Yokohama Bldg, 17F, 1-1-32 Shin-Urashimacho, Kanagawa-Ku, Yokohama, Kanagawa 221-0031)

** Packaging Research & Development Center, J-DEVICES Corp. Yokohama Head Office (New Stage Yokohama Bldg, 17F, 1-1-32 Shin-Urashimacho, Kanagawa-Ku, Yokohama, Kanagawa 221-0031)